



華潤勵致有限公司
China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期業績

- 營業額增加24%至42.64億港元。
- 半導體業務營業額增加45%，達30.17億港元。
- 半導體業務經營溢利增加30%，達3.25億港元。

華潤勵致有限公司（「本公司」或「華潤勵致」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合末期業績連同二零零六年的比較數字如下：

綜合收入報表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額	3		
持續經營業務		3,016,902	2,086,396
已終止經營業務		1,247,230	1,364,263
		<u>4,264,132</u>	<u>3,450,659</u>
銷售成本		(3,267,584)	(2,602,462)
毛利		996,548	848,197
其他收入		111,239	104,199
銷售及分銷開支		(156,336)	(129,972)
行政開支		(359,175)	(301,962)
其他開支		(233,239)	(161,255)
經營溢利	3	359,037	359,207
財務成本		(104,367)	(89,601)
應佔一家聯營公司業績		-	1,103
出售已終止經營業務收益	5	61,864	-
就結束一家生產廠房虧損	6	(69,868)	-
視作出售一家聯營公司收益		-	1,590
收購附屬公司折讓		-	41,296
除稅前溢利		<u>246,666</u>	<u>313,595</u>
稅項	4		
持續經營業務		(41,102)	(21,552)
已終止經營業務		(6,696)	(11,647)
		<u>(47,798)</u>	<u>(33,199)</u>
年內溢利	6		
持續經營業務		89,810	187,108
已終止經營業務	5	109,058	93,288
		<u>198,868</u>	<u>280,396</u>
應佔：			
本公司股本持有人			
持續經營業務		60,411	171,992
已終止經營業務	5	91,950	60,425
		<u>152,361</u>	<u>232,417</u>
少數股東權益		46,507	47,979
		<u>198,868</u>	<u>280,396</u>

綜合收入報表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

		二零零七年 港仙	二零零六年 港仙
每股股息	7		
已派中期股息		1.00	1.00
擬派末期股息		-	1.00
		<u>1.00</u>	<u>2.00</u>
每股盈利	8		
來自持續及已終止經營業務			
基本		<u>5.48</u>	<u>8.57</u>
攤薄		<u>5.37</u>	<u>8.49</u>
來自持續經營業務			
基本		<u>2.17</u>	<u>6.34</u>
攤薄		<u>2.11</u>	<u>6.28</u>

綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,949,268	4,217,639
預付租約款項		160,266	172,559
可供銷售投資		9,904	10,105
商譽		24,060	152,777
技術知識		35,678	53,663
遞延稅項資產		10,886	16,416
購置物業、廠房及設備按金		17,011	63,205
		<u>4,207,073</u>	<u>4,686,364</u>
流動資產			
存貨		813,870	1,068,568
應收賬款、按金及預付款項	9	1,029,983	1,622,459
預付租約款項		3,928	4,625
應收少數股東款項		-	2,164
可退稅項		4,172	10,057
已抵押銀行存款		6,030	7,642
銀行結存及現金		867,908	521,250
		<u>2,725,891</u>	<u>3,236,765</u>
分類為持作銷售的資產		46,708	-
		<u>2,772,599</u>	<u>3,236,765</u>

綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
流動負債			
應付賬款及應計費用	10	1,313,849	1,595,098
政府補助金-即期部分		13,221	10,520
應付少數股東款項		-	85,213
銀行借貸		682,762	1,706,617
撥備		42,183	77,111
稅項		10,327	8,133
		<u>2,062,342</u>	<u>3,482,692</u>
流動資產（負債）淨值		<u>710,257</u>	<u>(245,927)</u>
資產總值減流動負債		<u>4,917,330</u>	<u>4,440,437</u>
資本及儲備			
股本		281,215	276,580
股份溢價及儲備		<u>2,770,716</u>	<u>2,478,511</u>
本公司股本持有人應佔股本		3,051,931	2,755,091
上市附屬公司購股權儲備		10,840	5,805
少數股東權益		<u>515,041</u>	<u>1,048,727</u>
股本總值		<u>3,577,812</u>	<u>3,809,623</u>
非流動負債			
銀行借貸		1,174,746	522,306
長期應付款		66,026	66,025
政府補助金		98,746	42,483
		<u>1,339,518</u>	<u>630,814</u>
		<u>4,917,330</u>	<u>4,440,437</u>

附註：

1. 編製基準

綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務申報準則（「香港財務申報準則」）編製。此外，綜合財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的證券上市規則及公司條例規定的相關披露。

2. 採納新訂及經修訂的香港財務申報準則

於本年度，本集團已首次採納以下由香港會計師公會頒佈而於本集團在二零零七年一月一日開始的財政年度生效的新準則、修訂及詮釋（「新香港財務申報準則」）。採用新香港財務申報準則，並無對本集團於現行或過往會計期間的業績與財務狀況的編製及呈報方式產生重大影響。因此，毋須對過往期間作出任何調整。

香港會計準則第1號（修訂）	資本披露
香港財務申報準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第7號	根據香港會計準則第29號「惡性通貨膨脹經濟中之財務申報」 採用重列法
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第8號	香港財務申報準則第2號的範圍
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第9號	重估嵌入式衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第10號	中期財務申報及減值

本集團已追溯應用香港會計準則第1號（修訂）及香港財務申報準則第7號的披露規定。過往年度根據香港會計準則第32號的規定呈列的若干資料已被刪除，並於本年度首次根據香港會計準則第1號（修訂）及香港財務申報準則第7號的規定呈列相關比較資料。

本集團並無提早採納以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則及詮釋。本公司董事預料，採納該等準則及詮釋將不會對本集團業績及財務狀況產生重大影響。

香港會計準則第1號（修訂）	財務報表的呈列 ¹
香港會計準則第23號（修訂）	借貸成本 ¹
香港財務申報準則第8號	營運分類 ¹
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第11號	香港財務申報準則第2號－集團及庫存股份交易 ²
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第12號	服務經營權安排 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第13號	顧客忠誠計劃 ⁴
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第14號	界定利益資產之限制、最低撥款規定及其相互關係 ³

¹ 於二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零零七年三月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零零八年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁴ 於二零零八年七月一日或之後開始的年度期間生效

3. 業務及地區分類

業務分類

為方便管理，本集團經營業務劃分為兩大類：半導體及壓縮機。此等業務乃本集團呈報其主要分類資料的基準。

此等分部的業務如下：

半導體— 設計、製造及封裝集成電路及分立器件

壓縮機— 製造空調壓縮機

壓縮機業務已於二零零七年八月十六日終止經營。

截至二零零七年十二月三十一日止年度的業績

	持續 經營業務 半導體 千港元	已終止 經營業務 壓縮機 千港元	綜合 千港元
營業額			
外銷	3,016,902	1,247,230	4,264,132
業績			
分類業績	324,854	59,290	384,144
未分配開支			(35,824)
未分配收入			10,717
經營溢利			359,037
財務成本			(104,367)
出售終止經營業務收益	-	61,864	61,864
就結束一家生產廠房虧損	(69,868)	-	(69,868)
除稅前溢利			246,666
稅項			(47,798)
年內溢利			198,868

半導體業務的分類業績包括重組活動撥備撥回 25,858,000 港元。

截至二零零六年十二月三十一日止年度的業績

	持續 經營業務 半導體 千港元	已終止 經營業務 壓縮機 千港元	綜合 千港元
營業額			
外銷	2,086,396	1,364,263	3,450,659
業績			
分類業績	249,703	113,909	363,612
未分配開支			(25,212)
未分配收入			20,807
經營溢利			359,207
財務成本			(89,601)
應佔一家聯營公司業績	1,103	-	1,103
視作出售一家聯營公司收益	1,590	-	1,590
收購附屬公司折讓	41,296	-	41,296
除稅前溢利			313,595
稅項			(33,199)
年內溢利			280,396

地區分類

半導體分部業務於香港及中華人民共和國其他地區（「中國內地」）進行，壓縮機分部業務則於中國內地進行。

下表顯示本集團按地區市場劃分的持續經營業務銷售額分析：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中國內地	2,394,334	1,688,298
香港	208,550	166,163
美國	105,302	50,698
歐洲	27,446	22,871
其他	281,270	158,366
	3,016,902	2,086,396

年內，本集團來自已終止經營壓縮機業務的營業額為1,247,230,000港元（二零零六年：1,364,263,000港元），主要源自中國內地。

4. 稅項

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
稅項支出（撥回）包括：		
即期稅項		
中國內地	55,881	35,753
香港	712	-
過往年度超額撥備	(7,567)	-
	<u>49,026</u>	<u>35,753</u>
遞延稅項	(1,228)	(2,554)
	<u>47,798</u>	<u>33,199</u>

中國內地產生的利得稅乃根據應課稅溢利按適用稅率計算。

年內的香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按稅率17.5%計算。於過往年度，本集團並無產生任何須繳納香港利得稅的溢利，故此並無作出香港利得稅撥備。

若干於中國內地營運的附屬公司在扣除轉入的稅項虧損後由首個獲利年度起計兩年期間獲豁免繳納適用的中國企業所得稅，並於其後三年可獲減免50%中國企業所得稅。若干於中國內地營運的附屬公司被視為高新科技企業，並已獲當地稅務局授予稅項寬減。

5. 已終止經營業務

於二零零七年六月二十一日，本公司及其全資附屬公司 CRT (BVI) Limited 與 Gradison Limited (為華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)的全資附屬公司)訂立協議，以出售華潤制冷科技有限公司全部已發行股本，代價為1,170,000,000港元。華潤制冷科技有限公司為本公司的全資附屬公司，透過其附屬公司從事壓縮機生產業務。出售已於二零零七年八月十六日完成。

由二零零七年一月一日至二零零七年八月十六日期間的壓縮機業務業績已計入綜合收入報表，並載列如下：

	由二零零七年 一月一日至 二零零七年 八月十六日期間 千港元	截至 二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元
壓縮機業務溢利	47,194	93,288
出售壓縮機業務收益	61,864	-
	<u>109,058</u>	<u>93,288</u>
應佔：		
本公司股本持有人	91,950	60,425
少數股東權益	17,108	32,863
	<u>109,058</u>	<u>93,288</u>

6. 年內溢利

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
年內溢利已扣除（計入）：		
員工成本		
董事酬金	8,421	7,263
其他員工		
- 薪金及其他福利	393,734	400,723
- 退休福利計劃供款	37,267	35,095
股份付款開支	7,863	8,401
員工成本總額	447,285	451,482
核數師酬金	5,040	4,690
物業、廠房及設備折舊	437,444	326,170
投資物業折舊	-	1,367
技術知識攤銷	5,915	4,886
預付租約款項攤銷	4,522	4,615
存貨撇減至可變現淨值（包括在其他開支內）	46,209	37,321
研究、設計及發展開支（包括在其他開支內）	143,734	102,529
重組開支	11,000	-
物業、廠房及設備的減值虧損	2,844	9,271
租賃物業的經營租約租金	3,197	4,850
匯兌虧損淨值	886	1,129
就結束一家生產廠房虧損		
- 撇減存貨至可變現淨值	37,468	-
- 物業、廠房及設備的減值虧損	10,810	-
- 其他應收賬款的減值虧損	10,990	-
- 僱員遣散費開支	10,600	-
	69,868	-
銀行存款利息收入	(10,717)	(6,072)
出售物業、廠房及設備的收益	(8,311)	(6,337)
出售可供銷售投資的收益	(3,586)	-
來自投資物業的租金收入	-	(5,609)
減：直接租金開支	-	981
	-	(4,628)

7. 股息

於二零零六年六月十二日，本公司向股東派付截至二零零五年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.0港仙，合共53,406,000港元。

於二零零六年十月十日，本公司向股東派付截至二零零六年六月三十日止六個月的中期股息每股1.0港仙，合共27,667,000港元。

於二零零七年六月五日，本公司向股東派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.0港仙，合共27,671,000港元。

於二零零七年十月九日，本公司向股東派付截至二零零七年六月三十日止六個月的中期股息每股1.0港仙，合共27,937,000港元。

董事不建議派付截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息。

8. 每股盈利

就持續及已終止經營業務及持續經營業務而言

每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
盈利：		
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利		
本公司股本持有人應佔年內溢利	152,361	232,417
減：來自已終止經營業務的年內溢利	(91,950)	(60,425)
來自持續經營業務的年內溢利（指用以計算每股基本盈利的盈利）	60,411	171,992
附屬公司潛在攤薄股份對本集團持續經營業務應佔盈利的影響	(992)	(397)
用以計算每股攤薄盈利的盈利	59,419	171,595
股份數目：		
用以計算每股基本盈利的加權平均股份數目	2,781,703,639	2,713,044,353
潛在攤薄股份的影響		
購股權	37,527,925	18,630,526
用以計算每股攤薄加權平均股份數目	2,819,231,564	2,731,674,879

就已終止經營業務而言

根據來自已終止經營業務的溢利及以上呈列的分母計算，已終止經營業務的每股基本盈利為3.31港仙（二零零六年：每股2.23港仙），而其每股攤薄盈利則為3.26港仙（二零零六年：每股2.21港仙）。

9. 應收賬款、按金及預付款項

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
貿易應收賬款	934,248	1,513,595
減：應收呆賬撥備	(23,135)	(18,556)
	<u>911,113</u>	<u>1,495,039</u>
按金及預付款項	118,870	127,420
	<u>1,029,983</u>	<u>1,622,459</u>

本集團給予其貿易客戶的賒賬期一般為30天至90天，個別客戶的賒賬期可延至180天，視乎彼等的交易量及結算條款而定。已扣除呆賬撥備的貿易應收賬款（包括應收票據）的賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 - 60 天	587,632	802,195
61 - 90 天	125,151	176,328
91 - 180 天	186,420	396,316
180 天以上	11,910	120,200
	<u>911,113</u>	<u>1,495,039</u>

於二零零六年十二月三十一日的應收賬款包括於本集團在日常業務進行的交易所產生應收關連公司的應收票據109,156,000港元。有關款項為無抵押、免息及須於與本集團給予其主要客戶相若的信貸期內償還。於二零零七年十二月三十一日，並無尚未清償的應收票據。

10. 應付賬款及應計費用

應付賬款及應計費用中包括的貿易應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 - 60 天	585,494	729,403
61 - 90天	147,295	207,704
91 - 180天	241,814	411,069
180天以上	19,626	4,791
	<u>994,229</u>	<u>1,352,967</u>

購貨的平均信貸期為7天至180天。本集團已制定財務風險管理政策，以確保於有關信貸期內支付所有應付賬款。

於二零零七年十二月三十一日的應付賬款包括於本集團在日常業務進行的交易所產生應付關連公司的應付賬款104,473,000港元。有關款項為無抵押、免息及須於與本集團主要供應商所授相若的信貸期內償還。

11. 結算日後事項

於二零零七年十二月，本集團實施重組計劃，據此：

- 本公司與華潤上華訂立一項有條件協議，向華潤上華出售於本公司若干從事半導體業務的附屬公司的全部權益，以及該等附屬公司所獲授的股東貸款，總代價約1,488,900,000港元，將透過向本公司發行最少3,050,581,517股及最多3,210,167,717股華潤上華股份支付；
- 本公司亦與華潤混凝土有限公司訂立有條件協議，以現金代價217,757,665港元購入中港混凝土有限公司的全部已發行具投票權的股本。有關重組詳情及其財務影響已於二零零八年一月十六日發出之通函內列明及寄發予公司股東；及
- 本公司董事會議決在達致若干條件後，按每持有100股本公司股份可獲180股華潤上華股份的基準，向本公司股東以實物分派方式分派華潤上華股份。

上述計劃完成後，華潤上華將不再為本集團的附屬公司。本集團將不再從事半導體業務，轉而主要從事向港澳市場供應預拌混凝土及相關產品。

上述交易須達致若干條件後，方可作實。該等條件包括(i)獲得本公司及華潤上華的獨立股東批准以及(ii)獲得本公司、華潤上華及其各自的附屬公司貸款人的書面同意，並已於結算日後達成。

賬目審閱

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由本公司審核委員會（審核委員會由三名獨立非執行董事組成）審閱及本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審核。獨立核數師報告書將載於將寄發予股東的年報內。

末期股息

董事議決不建議派付截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息（二零零六年：每股1.00港仙）。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零八年四月二十九日起至二零零八年五月五日（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，填妥的過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零八年四月二十八日下午四時三十分前，交回本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

業績

現時國內的半導體行業只能滿足中國集成電路和分立器件總需求的約20%。近年，中國集成電路及分立器件的需求快速增長，預期在可見將來增長勢頭依然強勁。於二零零七年，中國集成電路市場的全年總收益高達520億美元，佔全球集成電路市場的24%。中國市場發展潛力龐大，是本集團擴充半導體業務的大好良機。年內，本集團半導體業務，尤其是晶圓代工及分立器件製造業務經營持續改善，鞏固對本集團半導體業務長遠發展的樂觀看法。住宅空調壓縮機行業產能過剩及原材料價格上漲影響年內本集團壓縮機業務的業績及本集團的整體表現。壓縮機業務已於二零零七年八月出售。

本集團於年內的經審核綜合營業額達4,264,000,000港元，較二零零六年增加24%。本集團於年內的毛利率為23%（二零零六年：25%）。本集團於年內的經營溢利為359,000,000港元，經營溢利率為8%（二零零六年：10%）。本集團於年內的股本持有人應佔溢利和每股基本盈利分別為152,000,000港元及5.48港仙（二零零六年：分別為232,000,000港元及8.57港仙）。

業務回顧

於二零零七年，本集團半導體業務表現繼續改善，綜合收益達3,017,000,000港元，較去年的2,087,000,000港元增加45%，成功為本集團提供穩固的平台，為進一步開拓中國龐大而增長迅速的半導體市場作好準備。

本集團壓縮機業務年內的表現未如理想，乃由於業內產能過剩及原材料成本上漲所致。該業務已於二零零七年八月出售，出售所得收益為62,000,000港元。

半導體業務

由於本集團半導體業務生產的集成電路產品壽命相對較長，屬於技術成熟的集成電路市場產品，並以中國為目標市場，比較以全球市場為目標的高端市場產品，價格波動相對輕微，半導體業務因而能夠維持穩定的毛利率。本集團將會繼續加強技術專長，為中國價格平穩但高速增長的集成電路市場生產更增值產品。本集團將繼續應用成功的業務模式，即使用成熟技術，從而以相對較低的資本開支進軍中國不斷

發展的模擬集成電路和分立器件市場。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，半導體業務營業額由去年錄得的2,087,000,000港元增加45%至3,017,000,000港元。營業額增加乃主要由於來自半導體晶圓代工及分立器件業務的營業額貢獻所致。年內的毛利率為27%，去年為29%。預期晶圓代工及封測業務進一步增長後，毛利率將於二零零八年提升至更高水平。截至二零零七年十二月三十一日止年度，半導體業務的經營溢利為325,000,000港元（二零零六年：250,000,000港元），增幅為30%。

本集團現時為中國最大的半導體企業之一，其半導體業務包括：

集成電路設計業務

無錫華潤矽科微電子有限公司是中國大陸技術和規模領先的集成電路設計公司之一，該公司以數字和數模混合信號處理技術為主導，設計開發MCU、音視頻處理SoC等半導體集成電路產品，廣泛應用於電視、音響、DVD及MP3播放機、電子遊戲機、通訊設備和語音合成等電子消費產品。

華潤矽威科技（上海）有限公司及無錫華潤芯功率半導體設計有限公司從事電源管理集成電路和高壓分立器件的開發和設計，這些產品具有廣闊的市場前景，將會對公司設計業務增長帶來積極的貢獻。

晶圓代工業務

華潤上華科技有限公司（「華潤上華」）是目前中國規模最大的6英寸晶圓代工企業。本集團現擁有的6英寸晶圓代工總產能規模已相當可觀，達每月80,000片。本集團合共擁有3條6英寸晶圓生產線，具備每月超過10萬片的6英寸晶圓代工產能及0.35微米功能，具備各種MOS、雙極和BICMOS，以及DMOS等工藝平台供客戶選擇。未來，本集團屬下6英寸晶圓代工將致力於向模擬產品代工轉型，以期達至更好的經營效益。

集成電路封測業務

本集團已與全球領先的集成電路封測代工企業STATS ChipPAC Ltd.合資設立無錫華潤安盛科技有限公司。該公司是中國大陸專注集成電路封測代工業務的重點企業之一，主要面向世界知名的半導體廠商提供集成電路封測代工服務，有引線封裝測試技術處於國內領先地位，月封裝能力達到25億線。本公司持有該合資公司75%的股份。

作為對本集團集成電路封測業務的支持，賽美科微電子（深圳）有限公司已成為國內規模最大的晶圓中測代工商。

分立器件製造業務

無錫華潤華晶微電子有限公司是中國大陸功率型半導體分立器件開發和製造領域的標杆，該公司年產4-6英寸分立器件晶圓1,500,000片，是中國大陸分立器件芯片和成品的主要供應商。本集團設於香港的華潤半導體有限公司是中國光電晶體管系列產品的主要供應商。本公司開發的上述分立器件產品應用於綠色照明、家用電器、工業控制儀器和個人計算機等領域。

壓縮機業務

隨著中國行業產能的增加，近年中國住宅空調壓縮機市場疲軟。原材料成本上漲使情況更進一步受壓。壓縮機業務已於二零零七年八月出售，出售所得收益為62,000,000港元。

截至出售日期，壓縮機業務的營業額為1,247,000,000港元，較二零零六年的1,364,000,000港元減少9%。然而，由於原材料成本持續上漲，毛利率由去年的18%減至15%。其經營溢利率為5%（二零零六年：8%）。年內錄得經營溢利59,000,000港元，較二零零六年的114,000,000港元下降48%。

重大投資、收購和出售事項

出售壓縮機業務

本集團於二零零七年八月向其控股公司華潤集團出售其壓縮機業務，出售代價為1,170,000,000港元，約為截至二零零六年十二月三十一日止年度壓縮機業務應佔未經審核綜合除稅後純利的20倍，並高於截至二零零六年十二月三十一日止年度的壓縮機業務應佔未經審核綜合資產淨值約10%。

合併半導體權益

於二零零七年十二月四日，本公司與華潤上華訂立有條件協議，以出售本集團的半導體業務（即其所有半導體業務，惟不包括於香港大埔經營4英吋晶圓廠的華潤半導體有限公司），代價約為1,488,900,000港元，已由華潤上華透過向本公司發行3,106,932,317股新股份支付。出售代價相當於被收購的半導體業務於二零零七年六月三十日的管理賬目所列的總資產淨值（經調整以反映支付股息約474,400,000港元）。

於二零零七年十二月四日，本公司與華潤集團（本公司的主要及控股股東）的附屬公司華潤混凝土有限公司訂立有條件協議，以購入中港混凝土有限公司的全部已發行具投票權的股本，現金代價為217,757,665港元。代價乃參考中港混凝土有限公司於二零零七年十月三十一日的綜合資產淨值及其近年的財務業績釐定。中港混凝土有限公司主要從事於香港生產及銷售預拌混凝土，亦從事生產及銷售預拌砂漿。

於二零零七年十二月四日，本公司董事會建議以實物方式向本公司股東分派其於華潤上華的股份，即按每持有100股本公司股份可獲180股華潤上華股份的基準作出分派，並已分派合共5,091,900,165股華潤上華股份（包括本公司持有的1,984,967,848股華潤上華股份及按照與華潤上華訂立有條件協議而配發（作為代價）予本公司的3,106,932,317股華潤上華股份）。上述分派達成後，華潤上華將不再為本公司的附屬公司，華潤上華的賬目不再綜合於本公司的財務報表中，除將予變賣及 / 或關閉的大埔4英吋晶圓廠外，本公司將不再從事半導體業務，轉而主要從事向港澳市場供應預拌混凝土及相關產品，並維持其於聯交所的上市地位。

於獲得必須的股東批准及達成所有必要條件後，上述交易已於二零零八年三月五日完成。

前景

中國市場對模擬集成電路的需求急劇增長，半導體業務將可繼續從中受惠。本集團於二零零二年收購一家領導地位的中國半導體企業以及其後成功進行重組及整合，為本集團創造了堅實的中國生產平台。為進一步鞏固本集團半導體生產平台及提升日後競爭力，本公司與STATS ChipPAC Ltd.（世界主要的集成電路封裝及測試代工服務供應商之一）於二零零六年六月訂立合資協議，以拓展測試及封裝業務。

本集團的集成電路設計公司，為中國領先集成電路設計公司，於年內大幅擴大其模擬集成電路產品組合，並加強其設計能力。本集團於近年從美國引進一批高質素的半導體設計人才，並將繼續招攬海外受訓的半導體專才，以提升本集團持續發展集成電路和分立器件的設計及生產的能力。

本集團經營晶圓代工業務的聯營公司華潤上華曾進行重組、集資及引進戰略性夥伴，以及其後於二零零四年在聯交所上市，為本集團晶圓代工業務的迅速擴展鋪路。本集團於二零零六年七月收購華潤上華的控股權益，使本集團晉升為中國最大半導體代工企業之一。

本集團經已晉身為中國成熟技術集成電路的翹楚，在製造和封裝模擬集成電路及分立器件、經營集成電路設計、提供晶圓代工服務技術方面享有舉足輕重的地位。

本公司與其附屬公司華潤上華科技有限公司的半導體業務於二零零八年三月合併，組成華潤微電子有限公司。經合併的華潤微電子有限公司將透過內部增長、外部收購及物色機會與海外及中國企業組成策略性夥伴，以繼續擴充其半導體業務。

於二零零八年三月，本集團收購中港混凝土有限公司的全部已發行具投票權的股本。該公司主要從事於香港生產及銷售預拌混凝土。

出售壓縮機及半導體業務及收購中港混凝土有限公司後，本集團轉型為預拌混凝土主要供應商。隨著本地物業市場復甦，以及香港的建造項目穩定增長，新收購業務的表現預期將進一步有所改善。本集團重新定位為香港建造及土木工程行業的主要預拌混凝土供應商，並期望日後在全中國發揮此角色。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何股份。

遵守企業管治常規守則及標準守則

本公司在年內一直遵守上市規則附錄 14 所載企業管治常規守則之規定。

本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則為董事進行證券交易之行為守則（「標準守則」）。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認，全體董事於本年度內均已遵守標準守則所載規定標準。

刊載年報於香港聯合交易所有限公司網站

二零零七年年報將於適當時候寄發予股東及在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.crlogic.com.hk）刊載。

承董事會命
華潤勵致有限公司
朱金坤
主席

香港，二零零八年三月二十日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事 ： 朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事 ： 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事 ： 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生